

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-004

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

为满足公司固定资产投资、日常生产经营需要，公司 2026 年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过 20 亿元（含）人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

为解决以上授信额度所需担保事宜，公司可使用自有的土地使用权、固定资产、在建工程等资产提供抵押担保。公司可以根据资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行授信额度内，提请授权公司法定代表人签署一切授信相关的法律文件，同时提请授权公司财务负责人协助公司具体落实上述授信的相关手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2026年2月10日